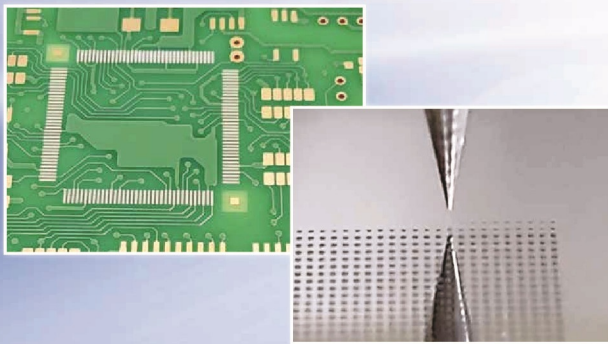


Twin-air[®] ディispensサ搭載

卓上型ディispensシステム

EDシリーズ



ED20-L01

Twin-air[®] 搭載



ED20-P01

Twin-air[®] lite 搭載



Φ100μmドットを狙える卓上システム

X-Yテーブルで振動抑制、高品質塗布を実現

研究開発・試作・少量多品種生産へ最適

各種ワークへの対応

- プリント基板、ガラス、セラミック
金属基板、樹脂フィルム
- 2～4インチ各種ウエハ
- 各種3Dワーク、キャビティ内部

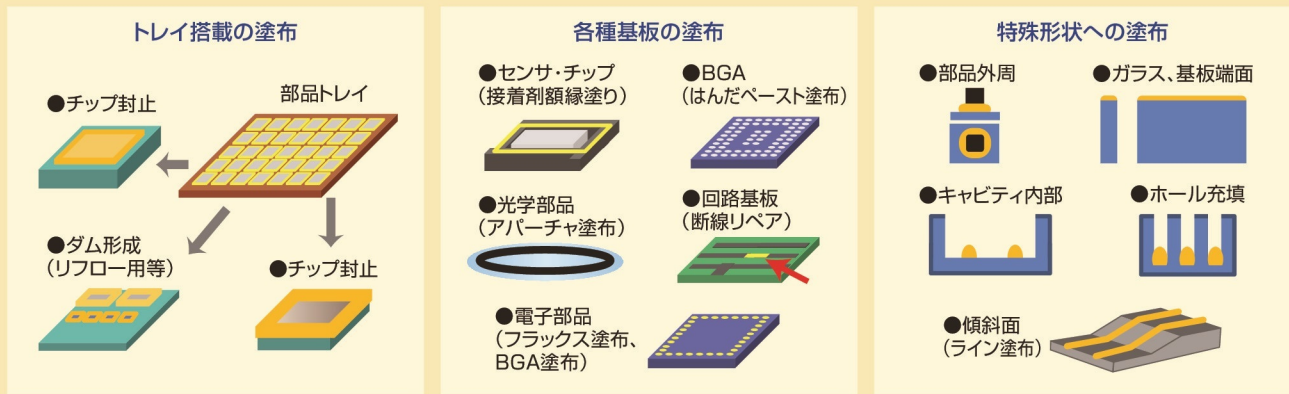
パフォーマンス

- 高粘度液剤の微量塗布 Φ100μm、100μm幅
- マスクレスで簡単にパターン描画を実現
- 塗布条件のレシピ化により、容易に条件設定
- 塗布パターンのCADデータインポート

各種液剤への対応

- 1000Pa・sの高粘度に対応、100μm幅
ライン、100μm径ドットを実現
- PC基板用・・・はんだペースト、溶剤レジ
スト、フラックス、防湿剤
- 樹脂材料・・・UV硬化接着剤、エポキシ、シリ
コン、ポリイミド、各種レジスト
- 導電性材料・・・Ag/Cu/Au(ナノ)ペースト、導
電性接着剤、各種導電インク
- カーボンブラックインク、酸化チタン溶液、その
他各種インク

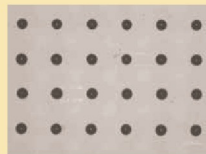
塗布アプリケーション例



塗布・描画例 (サイドビュー・イメージ、顕微鏡写真、バードビュー)



UV硬化樹脂
Φ130μm



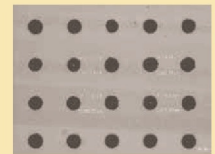
Ag ナノペースト
Φ100μm



塗布動作の
バードビュー・イメージ



サイドビューイメージ
ハンダペースト
Type6 Φ180μm



ハンダペースト
Type6 Φ120μm

■ 主な仕様

項 目	ED20-L01	ED20-P01	ER20
搭載ディスペンサ	Twin-air ベーシックファンクション	Twin-air lite ライトファンクション	—
ノズル内径サイズ (μm)	セラミックス製 25,40,70,100,150,200 (標準) 特注サイズ製作可能	金属製100～400 (標準は50μmピッチ)	—
有効塗布エリア (mm)	X 方向:140mm、Y 方向:200mm (搭載可能基板サイズ:200mm□以下)		
X-Yステージ駆動	ステッピングモータ(マイクロステップ駆動)		
搭載可能基板サイズ	200×200mm以下、t=6mm以下		
オートアライメント光学系	標準搭載		
搭載機能	オフセット・トップビュー&サイドビュー光学系、レーザー変位計、インターロック機構、CADデータインポート		
オプション	コンソールボックス、真空ポンプ、ノズル洗浄ユニット、ノズル先端位置検出ユニット、ステンレス製作業台*		
ユーティリティ	電源:AC100V 700W、クリーンドライエア:0.5～0.7MPa、真空		
装置サイズ、重量	W500×D800×H980 100kg以下		

※ 搭載オプションにより、有効塗布エリアが狭くなる場合があります。

● 仕様やオプションは、予告なく変更する場合があります。詳細仕様につきましては営業担当までお問合せください。

● ED20-P01は空圧やトリガ時間は手動設定となります。

● デモ、テストや試作を承っておりますので、ご相談ください。